

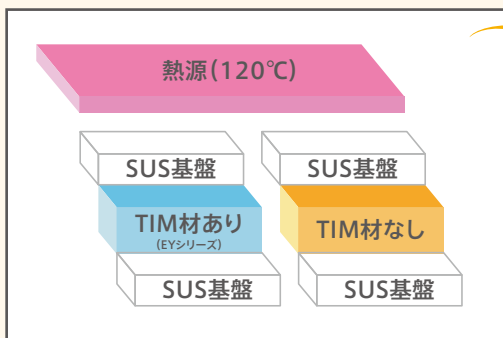
# 非シリコン系放熱ギャップフィラー

## 特徴

高热伝導性フィラーと非シリコン樹脂由来の柔軟性により、様々な形状の発熱体と放熱体(ヒートシンク)間の熱伝導性を高めます。

### ① 高热伝導性

測定条件: 120°Cの熱源でSUS板を加熱後、数秒後の温度変化をサーモグラフィーで測定

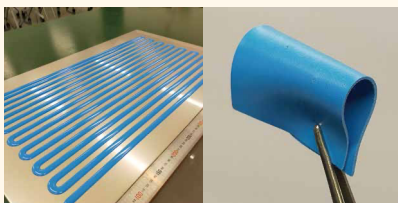


熱伝導率  
3W/mK

測定結果



### ② 樹脂由来の柔軟性



### ③ 低摩擦による塗布機への負担軽減

機械摩擦性の比較



アルミナと比較し機械的摩擦が少ない

## 物性データ

	主剤	硬化剤
色	水色	白
配合比(重量比/容量比)	2	1
粘度(Pa·s)	200	100~200
比重	2.8	2.5

### 物性一覧(混合時)

熱伝導率(W/mK) 60μm厚	3.0
ポットライフ(h)	0.5~6
硬化時間(h) 室温	0.5~24
硬度(ShoreC)	80
せん断強度(MPa·s)	0.9
破断強度(MPa·s)	1.12
表面抵抗値(Ω·cm)	10 <sup>10</sup> ~10 <sup>11</sup>
体積抵抗値(Ω·cm)	10 <sup>14</sup>
誘電率 1 MHz	6.34
誘電正接 1 MHz	0.035
難燃性(UL94)	V-0相当

フィラー・樹脂の一貫生産と配合技術により、用途や目的に応じて、カスタマイズします。ご要望をお聞かせください。

今資料の物性データは、特定条件下での当社評価結果であり、保証値ではありません。